

銘承 ViTrox 視覺檢測系統 新機亮相

專業於半導體元件外觀檢測設備代理的銘承科技，為提供客戶更快速的視覺檢測需求，特別導入 ViTrox 最新產品「TR1100i」至國內。該產品於設備第一視檢站採用了 2Kx2K 攝像機，專門為廣泛類型如 QFP、TSOP、BGA、CSP 等封裝執行底部 3D 檢測，及為 QFN 封裝執行側面檢測，可檢測 2mm×2mm 到 42.5mm×42.5mm 的尺寸，其第一檢測站備有管腳檢測、錫球檢測及 QFN 檢測，第二檢測站備有 2D 檢測、印字檢測、表面檢測及被動元件檢測。

TR1100i 最具優勢的是，在托盤至卷帶檢測系統配備了三吸嘴設計予以更快速封裝拾取，進而促進高產量至每小時 18K（托盤至卷帶）；雙托盤運送管道設計也大大地縮短運送時間，提高生產量並以電腦化方式調整卷帶範圍（自動卷帶轉換功能），從而簡易化整個調整過程；於 3D 檢測模組檢測站則備有單排吸嘴（1×14 隻）及雙排吸嘴（2×14 隻）規格供客戶選配，此功能可提高機器托盤至托盤之產量至 54K，並設有自動間距調整功能，可更快更準確地調整吸嘴間距離。此外，TR1100i 配備翹曲夾持器以調整托盤不平衡之用，使機器可以更平穩地操作，並支援額外 2D 印字視檢功能，以快速檢測封裝並提高生產量，也採用最少轉換步驟，只需使用一組背光板就可完成簡易配置。

銘承科技團隊表示，ViTrox 推展此 TR1100i 托盤至卷帶檢測機台，為因應輕薄短小封測產品測試之市場需求，也確實受到半導體封測大廠之肯定。而後，ViTrox 將陸續展開一系列產品行銷。

https://tw.news.yahoo.com/銘承_vitrox_視覺檢測系統-新機亮相-215005726--finance.html